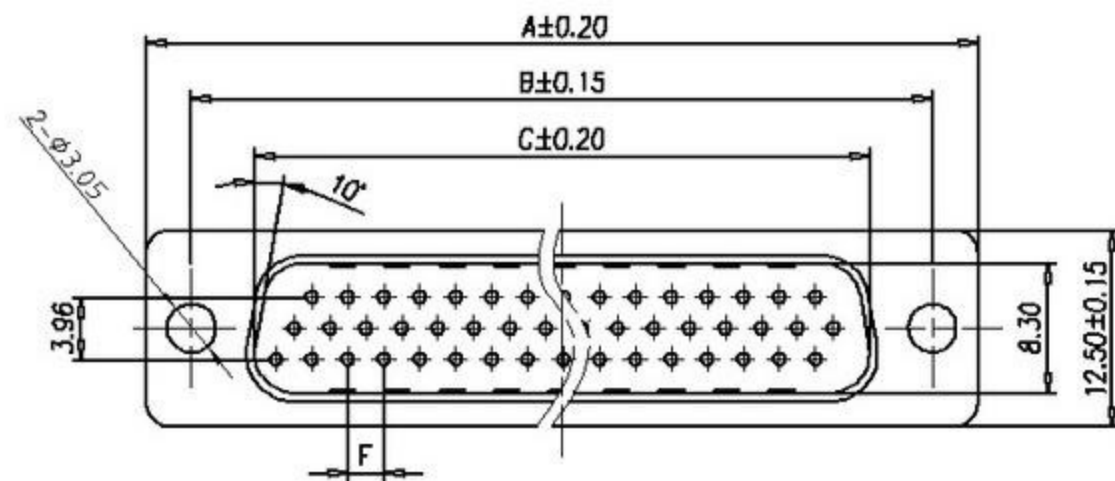
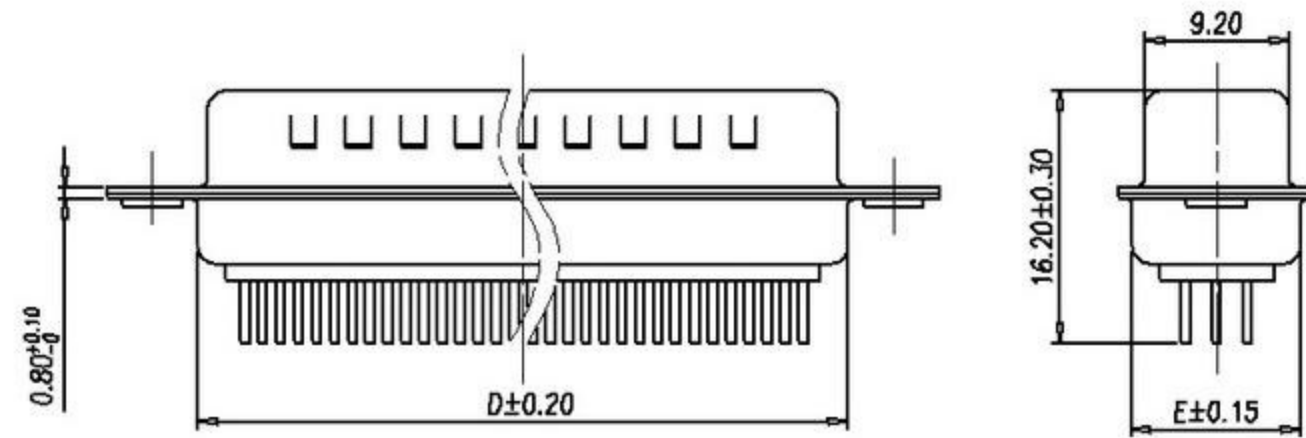
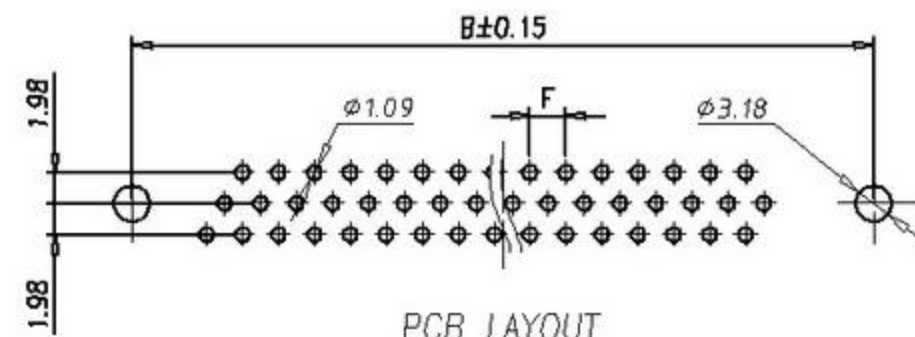


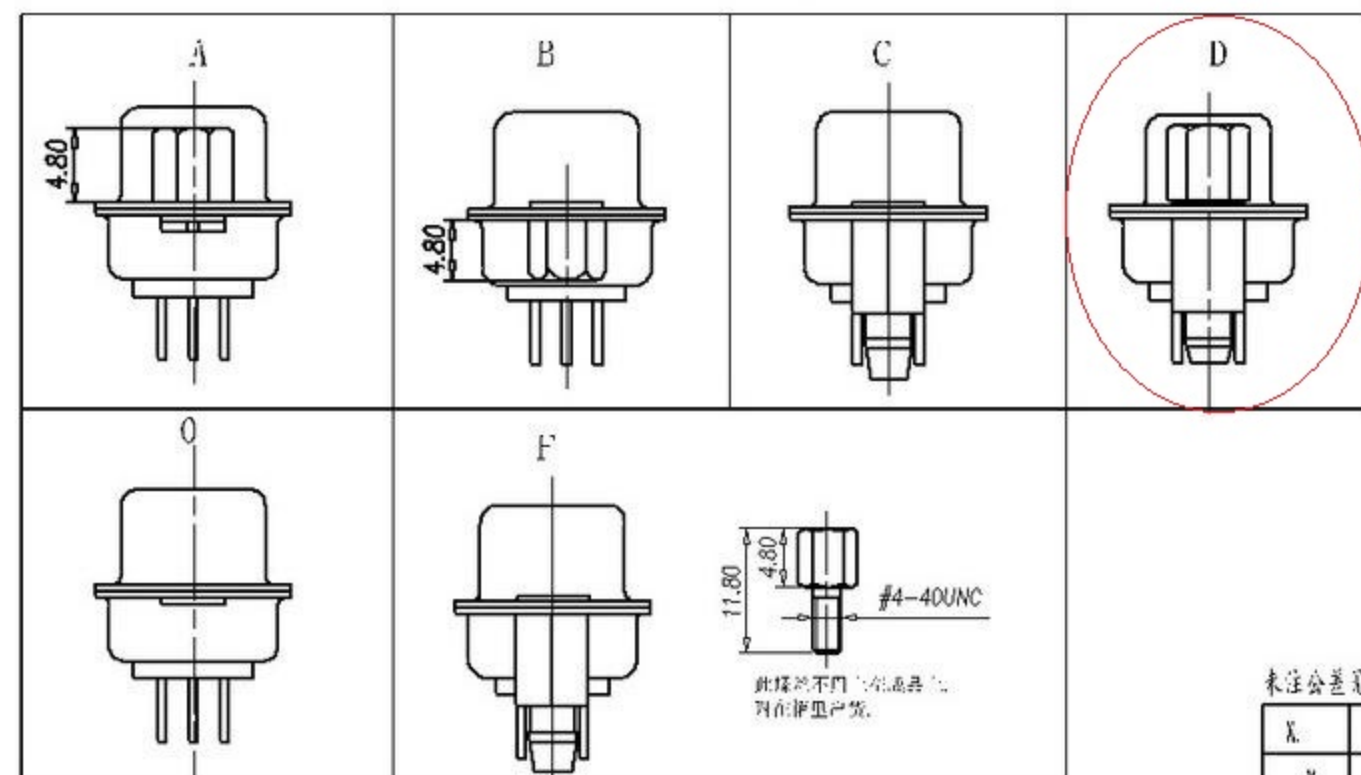


PIN DIM	HDP15P	HDP26P	HDP44P	HDP62P
A	30.80	39.20	53.05	69.40
B	25.00	33.30	47.05	63.50
C	16.90	25.25	38.95	55.40
D	19.20	27.50	41.10	57.30
E	10.80	10.70	10.70	10.80
F	2.29	2.29	2.29	2.41



PCB LAYOUT

铆钉型式说明



未注公差见下表:

X	±0.50	X°	±3°
.X	±0.38	.X°	±2°
.XX	±0.25		

技术要求:

1. 材料:

胶体: PBT+30%GF, UL94V-0, 颜色见编码规格表

引脚材料及镀层: 黄铜, 接触区 Gold flash 焊接区 Sn 3~5μm

外壳材料及镀层: SPCC, 前壳镀Ni 1.0μm, 后壳镀Sn 3~5μm

2. 电气性能:

额定电流: 3A

耐电压: 1000Vr.m.s, 1mA, 60s

绝缘电阻: ≥5000MΩ

接触电阻: ≤25mΩ

3. 机械性能:

插入力: ≤2.0N/pin

拔出力: ≥0.2N/pin

机械寿命: 500次

4. 环境参数

工作温度: -40℃~+100℃

湿度: ≤93% (40℃时)

耐焊接热: 245℃±5℃, 10s

5. 包装和储存

包装方式: 吸塑盘、大外箱

储存条件: 环境温度-10℃~+40℃

相对湿度在80%以下

6. 安装方式: PCB板方式安装。

7. 产品环保信息

RoHS符合性: 符合欧盟RoHS

1404 - XX X - X X- 1						
系列代码	产品pin数代码	公母代码	安装方式代码	镀层代码		
代码	定义	代码	定义	代码		
15	15pin	1	公	1	Gold flash	Gold flash
26	26pin	2	母	5	Gold flash	Sn3~5μm
44	44pin			6	Au 5u"	Sn3~5μm
62	62pin			7	Au 15u"	Sn3~5μm
				8	Au 30u"	Sn3~5μm
				S	Sn3~5μm	Sn3~5μm

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	马杰	2010.05.09		
审核	冯燕锦	2010.05.10		
工艺	潘凤	2010.05.11		
标准化	王海海	2010.05.12		
批准	张涛	2010.05.14		

D-SUB高密度直插公座

UL0.1404.XX1

投影标记	版次	重量	比例
AO			

荣丰五金有限公司